木林森股份有限公司

关于签订合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本协议为战略框架性协议,属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意 向性的约定,后续业务合作的具体实施内容将以另行签订的正式合作协议为准。 本协议的执行情况尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
- 2、本协议对公司2018年度经营业绩的影响需视协议双方后续具体合作协议 的签订和实施情况而定。

一、合同签署概况:

2018年5月28日,木林森股份有限公司(以下简称"公司")与井冈山经济 技术开发区管委会(以下简称"井冈山经开区")经友好协商,签订了《木林森 高科技产业园第四期项目合作框架协议》,本着平等、自愿、诚实信用、互惠互 利、共同发展的原则, 达成框架性合作协议。

二、交易对手方介绍:

井冈山经开区为井冈山经济技术开发区的管理单位。井冈山经济技术开发区 位于江西省吉安市城南,规划面积46.5平方公里,是全国加工贸易梯度转移重 点承接地、国家电子信息高新技术产业化基地、国家科技兴贸创新基地、江西省 电子信息产业基地,也是江西省政府和深圳市政府共创共建的吉安(深圳)产业 园。2001年11月经市政府批准设立,2002年3月正式动工建设,2010年3月 升级为国家级经济技术开发区,2011年3月批准设立国家出口加工区。

经过十余年发展, 井冈山经济技术开发区产业集聚效应明显, 已成为吉安市 发展工业的龙头和主战场。尤其是电子信息产业是井冈山经济技术开发区首位产 业,被国家工信部和科技部分别认定为国家电子信息新型工业化产业示范基地、 国家电子信息高新技术产业化基地。已形成涵盖各类电子元器件和终端产品的较 为完整产业链。

公司与井冈山经开区不存在关联关系,本次合作事项不涉及关联交易。

三、合同的主要内容

甲方: 井冈山经济技术开发区管委会

乙方: 木林森股份有限公司

(一)、项目情况:

乙方在井冈山经济技术开发区投资建设的项目,目前一、二、三期项目已基本达到序时进度;现启动第四期半导体生产项目;该项目主要从事半导体封装测试、生产、销售。

(二)、甲方责任

1、甲方给予乙方相关支持政策;

(三)、乙方责任

- 1、乙方负责项目的统一管理;
- 2、乙方负责购置生产设备进行生产,并力争使项目增产,为甲方创造税收;
- 3、乙方协助甲方引入与项目相关的上下游配套企业。
- (四)、本协议未尽事宜,由甲、乙双方另行协商并签订补充协议。
- (五)、本协议一式三份,乙方执两份,甲方执一份;本协议经甲、乙双方签字(盖章)后经乙方董事会及股东大会通过并公告之日起开始生效。

四、对上市公司的影响

我国 LED 产业呈高速增长态势,初步形成了比较完整的研发和产业体系,产业总体规模持续壮大。为抓住发展机遇,公司通过与井冈山经济技术开发区管委会签署合作协议,能够实现公司产品的多元化和业务互补,延伸产业链,增加公司盈利点和利润额。

本次合作符合公司的产业布局和发展战略,能够进一步提高公司的持续竞争力,对促进公司长期稳定发展具有重大作用。

五、风险提示:

本协议为战略框架性协议,属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性

的约定,后续业务合作的具体实施内容将以另行签订的正式合作协议为准。本协议的执行情况尚存在不确定性。

本协议具体的合作项目仍需进一步签署相关协议,公司将按照相关规定,对 具体合作项目履行相应决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件:

1、《木林森高科技产业园第四期项目合作框架协议》 特此公告。

> 木林森股份有限公司董事会 2018年5月29日